センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム人・機械インタラクションWG主査 武居 淳副査 野村 健一、古志 知也HCI 勉強会担当 平間 宏忠

令和7年度 第4回 人・機械インタラクションWG (HCI 勉強会) 開催のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのワーキンググループ活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。11月26日に産業技術総合研究所 -人間社会拡張研究部門シンポジウム(RIHSArch2025)-が開催されます。人とコンピューターの間で生まれる相互作用を研究する学問である Human Computer Interaction(HCI)の勉強会の一環として当該シンポジウムのインタラクティブセッション(ポスター発表・デモ)のエスコートツアーを行います。下記要領にて、開催いたしますのでご出席のほどよろしくお願いいたします。

敬具

記

日時:2025年11月26日(金) 10:40~12:00 ※シンポジウムは9:15~17:45まで開催されています。

集合場所:柏の葉カンファレンスセンター2F・ホワイエ

※入場にはシンポジウム RIHSArch2025 の申し込み(無料)が必須となります。下記 HP より シンポジウム参加申し込みを当 WG への参加申し込みとは別途行ってください。

【RIHSArch2025 参加登録 URL】https://unit.aist.go.jp/rihsa/symposium/RIHSArch2025/

予定議題

10:40~11:45 RIHSArch2025 インタラクティブセッション見学(主査 武居がエスコートいたします)

11:45~12:00 次回案内、事務連絡等、その後現地解散

【事務局】

国立研究開発法人産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内 センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム 人・機械インタラクションWG事務局

M-stri-SenTePack-hint-ml@aist.go.jp

※現在参加者募集中